

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人 長谷川 芳樹 様 あて名 〒100-0005 日本国東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 MY P L A Z A（明治安田生命ビル）9階 創英国際特許法律事務所	P C T 国際調査機関の見解書 （法施行規則第40条の2） [P C T規則43の2.1]
発送日 （日.月.年） 13. 11. 2018	

出願人又は代理人 の書類記号 18P00517W00	今後の手続については、下記2を参照すること。
-------------------------------	------------------------

国際出願番号 P C T / J P 2 0 1 8 / 0 3 0 8 3 3	国際出願日 （日.月.年） 21. 08. 2018	優先日 （日.月.年） 29. 09. 2017
---	-------------------------------	-----------------------------

国際特許分類（I P C） Int.Cl. H05K1/05(2006.01)i, F04B39/00(2006.01)i, H05K1/02(2006.01)i, H05K1/14(2006.01)i, H05K3/44(2006.01)i, F16B5/10(2006.01)n

出願人（氏名又は名称） 株式会社 I H I

<p>1. この見解書は次の内容を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 見解の基礎 <input type="checkbox"/> 第II欄 優先権 <input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 <input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如 <input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 P C T規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 <input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献 <input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の欠陥 <input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願についての意見 <p>2. 今後の手続</p> <p>国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がP C T規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。</p> <p>この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式P C T / I S A / 2 2 0を送付した日から3月又は優先日から2月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。</p> <p>さらなる選択肢は、様式P C T / I S A / 2 2 0を参照すること。</p>
--

見解書を作成した日 31. 10. 2018

名称及びあて先 日本国特許庁（I S A / J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 原田 貴志 電話番号 03-3581-1101 内線 3551	5 D 4 6 9 0
---	---	-------------

第 I 欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

- 出願時の言語による国際出願
 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

2. この見解書は、PCT規則 91 の規定により国際調査機関が許可した又は国際調査機関に通知された明らかな誤りの訂正を考慮して作成した (PCT規則 43 の 2.1(b))。

3. この国際出願で開示されたヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下の配列表に基づき見解書を作成した。

- a. 出願時における国際出願の一部を構成する配列表
 附属書C/ST.25テキストファイル形式
 紙形式又はイメージファイル形式
- b. 国際出願とともに、PCT規則13の3.1(a)に基づき国際調査のためにのみ提出された、附属書C/ST.25テキストファイル形式の配列表
- c. 国際出願日後に、国際調査のためにのみ提出された配列表
 附属書C/ST.25テキストファイル形式 (PCT規則13の3.1(a))
 紙形式又はイメージファイル形式 (PCT規則13の3.1(b)及びPCT実施細則第713号)

4. さらに、複数の版の配列表又は配列表の写しが提出され、変更後の配列表又は追加の写しに記載された情報が、出願時における配列表と同一である旨、又は出願時における国際出願の開示の範囲を超えない旨の陳述書の提出があった。

5. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項	1-8	有
	請求項		無
進歩性 (I S)	請求項		有
	請求項	1-8	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求項	1-8	有
	請求項		無

2. 文献及び説明

文献 1: WO 2012/053580 A1 (矢崎総業株式会社) 2012. 04. 26, 段落[0011]-[0062], 図 1-7 & US 2013/0206443 A1, 段落[0011]-[0091], 図 1-7 & EP 2632005 A1 & CN 103181045 A

文献 2: JP 2-177492 A (三菱化成株式会社) 1990. 07. 10, 第 2 頁左上欄, 第 1 図 (ファミリーなし)

文献 3: WO 2013/018330 A1 (三洋電機株式会社) 2013. 02. 07, 段落[0025], 図 4 & US 2014/0085834 A1, 段落[0040], 図 4

文献 4: JP 2011-100816 A (電気化学工業株式会社) 2011. 05. 19, 段落[0016], [0017] (ファミリーなし)

請求項 1, 2, 5-8 に係る発明は, 国際調査報告で引用された文献 1, 2 より, 進歩性を有しない。

A) 請求項 1, 5, 6 について

文献 1 には, 第 1 側面部を有し, 表面に電気回路が形成されたコア金属板 2a (第 1 基板部) と, 第 2 側面部を有し, 前記電気回路に接続されるコネクタ 7b (導電部材) が固定されるコア金属板 2b (第 2 基板部) と, 前記第 1 側面部と前記第 2 側面部とに挟まれ, コア金属板 2b をコア金属板 2a に連結すると共に電氣的に絶縁するエポキシ樹脂で埋め固められた間隙 3 (樹脂製の絶縁部) とを有し, コア金属板 2b は, コネクタ 7b を固定するための第 2 接続部 73b (固定部材) が挿通される貫通孔を有する回路基板の発明が記載されている。

一方, 文献 1 に記載の発明は, コア金属板 2a の裏面, コア金属板 2b の裏面及び間隙 3 の裏面に設けられた補強部とを備え, 前記補強部は, 間隙 3 がコア金属板 2a に接する第 1 境界を覆う部分と, 間隙 3 がコア金属板 2b に接する第 2 境界を覆う部分とを有することが特定されていない点で, この出願の上記請求項に係る発明と相違する。

上記相違点について検討すると, 金属ベースプリント配線板において, そりやねじれが生じないように, 裏面に補強部を形成することは, 例えば文献 2 に記載されるように, 周知技術であり, 文献 1 に記載の発明において, 当該周知技術を採用することで, 上記相違点に係る構成をなすことは, 当業者であれば容易に想到し得るものである。

(補充欄に続く)

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

B) 請求項 2, 7, 8 について

この出願の請求項 2 に関して、文献 1 に記載の発明において、裏面に補強部を形成するにあたり、どのような形状とするかは、設計的な事項である。

また、この出願の請求項 7 に関して、文献 1 において、第 2 接続部 73b の固定方法や、上記回路基板を含む電気接続箱をどのような用途に用いるかは、当業者が適宜選択し得た事項である。

よって、この出願の請求項 1, 2, 5-8 に係る発明は、文献 1 に記載の発明に基づき、例えば、文献 2 に記載の周知技術を勘案することで、当業者が容易に発明することができたものである。

請求項 3, 4 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1-4 より、進歩性を有しない。

文献 1 に記載の発明は、コア金属板 2a, 2b がアルミニウムからなり、その側面部は、間隙 3 との接合強度を高めるためにアルマイト膜が形成されたことが特定されていない点で、この出願の上記請求項に係る発明と相違する。

上記相違点について検討すると、金属ベース回路基板において、アルミニウムからなる金属ベースを用いることや、アルミニウムからなる金属ベースと絶縁樹脂との間の密着力を高めるため、金属ベースの絶縁樹脂が接する面にアルマイト処理を行うことは、文献 3, 4 に記載されるように、周知技術であり、文献 1 に記載の発明において、当該周知技術を採用することで、上記相違点に係る構成をなすことは、当業者であれば容易に想到し得るものである。

よって、この出願の請求項 3, 4 に係る発明は、文献 1 に記載の発明に基づき、例えば、文献 2-4 に記載の周知技術を勘案することで、当業者が容易に発明することができたものである。